

**Sensorvorrichtung, Herstellungsverfahren und  
Detektionsvorrichtung**

Die Erfindung betrifft eine Sensorvorrichtung, insbesondere eine Time-of-flight- (TOF-) und/oder CCD-Sensorvorrichtung für einen 3-D-Kamerasensor nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein Verfahren zur Herstellung der Sensorvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 12 sowie eine Detektionsvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 15.

Während einerseits ein allgemeiner Trend zu immer stärkeren Miniaturisierungen im Chipdesign besteht, sind andererseits viele Chips und optoelektronische Sensorvorrichtungen nur sehr eingeschränkt einsetzbar und müssen zum Teil aufwendig unter Bereitstellung einiger Peripheriegeräte in Kameras oder andere Sensoreinrichtungen implementiert werden. Schwierigkeiten können insbesondere auftreten, weil entsprechende Sensoreinrichtungen zu groß und zu aufwendig sind, aber vielfach auch in Bezug auf die anwendungsbezogenen Anforderungen die nötige Robustheit fehlt.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Sensorvorrichtung sowie ein Verfahren zu deren Herstellung vorzuschlagen, die eine verbesserte Integration in anwendungsbasierte Sensoreinrichtungen bzw. Detektionsvorrichtungen ermöglicht.

Die Aufgabe wird, ausgehend von einer Sensorvorrichtung sowie einem Verfahren zu deren Herstellung bzw. einer Detektionsvorrichtung der eingangs genannten Art, durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1, des Anspruchs 12 sowie des Anspruchs 15 gelöst.

Durch die in den abhängigen Ansprüchen genannten Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen und Weiterbildungen der

Erfindung möglich.

Dementsprechend zeichnet sich eine erfindungsgemäße Sensorvorrichtung dadurch aus, dass die Schaltkreiskomponenten einschließlich dem Analog-Digital-Wandler als integrierter Schaltkreis in einen Chip integriert sind, wobei der Chip in 1-Poly-Technologie gefertigt ist.

Bei der erfindungsgemäßen Sensorvorrichtung handelt es sich insbesondere um einen Time-of-flight- (ToF-) und/oder eine CCD- (Engl.: Charge coupled device) Sensorvorrichtung für einen 3-D-Kamerasensor. Eine typische industrielle Anwendung besteht beispielsweise darin, eine Überwachungsvorrichtung für eine Tür, ein Torsystem oder dergleichen bereitzustellen. Die Erfindung ermöglicht, ein so genanntes System-on-Chip (SoC) für eine pixelbasierte Erfassung eines 3-D-Raumes zur Verfügung zu stellen, welche insbesondere auch für Industrieanwendungen geeignet ist. Die Sensorvorrichtung kann als Kernstück einer 3-D-Kamera, also als 3-D-Kamerasensor dienen, wobei sie vorzugsweise als Time-of-flight- bzw. CCD-Sensorvorrichtung ausgebildet ist.

Die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung umfasst wenigstens eine analoge und digitale Schaltkreiskomponente sowie einen Analog-/ Digital-Wandler zum Wandeln analoger Signale der analogen Schaltkreiskomponenten in digitale Signale für die digitale Schaltkreiskomponente und umgekehrt. Beide Arten von Schaltkreiskomponenten, nämlich analoge und digitale Schaltkreiskomponenten, umfassen jeweils so genannte Module, welche eine elektronische Ausführung einer Funktion (z.B. Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Treiberfunktionen, Phasenabgleich, Verstärkungen usw.) ermöglichen. Ein Modul der analogen Schaltkreiskomponente ist bei der erfindungsgemäßen Sensorvorrichtung als Sensoreinrichtung zur Detektion elektromagnetischer Strahlung, insbesondere IR-Strahlung, ausgebildet. Vorzugsweise kommen Anwendungen im Bereich der optischen bzw. optoelektronischen Sensorik in Betracht (z.B. im sichtbaren Bereich (ca. 400 nm -800 nm Wellenlänge), Ultraviolett- (UV) bzw. IR-Bereich). Gerade bei

Überwachungssystemen kann es sich regelmäßig um die Detektion von Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) handeln. Eine wichtige Funktion von Modulen der analogen Schaltungskomponente sind somit vor allem die im eigentlichen Sensor (ToF-Sensor, CCD) stattfindende Beeinflussung bzw. der Transport freier Ladungsträger (Engl.: free-charge handling).

Wenigstens ein Modul der digitalen Schaltungskomponente ist darüber hinaus als Signalverarbeitungseinrichtung zur Verarbeitung digitaler Signale ausgebildet, eine so genannte Digitaldomain zur Signalverarbeitung. Weitere Funktionen, die von zusätzlichen Modulen der digitalen Schaltungskomponente ausgeführt werden können, betreffen zum Beispiel die Phasenmodulation, Messen und Regeln von Phasenverschiebungen, sofern diese Funktionen beispielsweise für Time-of-flight-Messungen benötigt werden.

Durch die Maßnahme, dass die Sensorvorrichtung in einem einzigen Chip integriert ist und somit eine System-on-Chip-Lösung bereitgestellt wird, kann die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung besonders gut in verschiedenste Sensoren, Sensorvorrichtungen, Kameras, Überwachungsvorrichtungen usw. integriert werden. Neben der Benutzerfreundlichkeit, welche diese Integration ermöglicht, bietet die erfindungsgemäße Vorrichtung zudem auch Kostenvorteile, da die einzelnen, mitunter teuren Funktionsmodule bereits in dem einen Chip integriert sind. Insbesondere bietet die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung bzw. das erfindungsgemäße System-on-Chip eine besondere Platzersparnis, durch welche die Integrationsmöglichkeiten in die verschiedensten Anwendungssysteme zudem noch erhöht werden.

Die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung in Form eines System-on-Chip ermöglicht folglich die Integration von Modulen für alle für einen Sensor wichtigen Funktionen, wodurch sie besonders vorteilhaft in verschiedenste Systeme implementiert werden kann. Dadurch kann zum Beispiel eine Detektionsvorrichtung, welche die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung verwendet, besondere Robustheit in Bezug auf

unterschiedlichste anwendungsbezogene Anforderungen (Umgebungslicht, Erfassung von Objekten mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften wie z.B. Reflexionsvermögen) erfüllen.

Die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung bzw. das erfindungsgemäße System-on-Chip ist in 1-Poly-Technologie (Engl.: single-polysilicon technology) gefertigt. Gestapelte Doppelstrukturen (2-Poly) werden damit vermieden, der Aufbau wird damit grundsätzlich flacher und zudem weniger komplex. Der gesamte Chip, insbesondere auch die CCD, kann gemäß der Erfindung entsprechend in 1-Poly-Technik hergestellt werden. Üblicherweise werden CCD-Chips in 2-Poly-Technologie gefertigt.

Besonders bevorzugt ist die Integrierung eines nicht flüchtigen Speichers (Engl.: non-volatile memory) auf dem Chip zur Speicherung von Konfigurationsparametern, insbesondere eines EEPROM (engl.: Electrically erasable programmable read-only memory). Dies ermöglicht einen entscheidenden Schritt zu einem voll integrierten System-on-Chip, das nicht nur eine kompakte und platzsparende Bauweise besitzt, sondern auch selbst wiederum hervorragend in Sensoren und Messvorrichtungen integriert werden kann. Zudem kann die Robustheit eines solchen voll integrierten Variante gemäß der Erfindung deutlich gegenüber herkömmlichen Sensorvorrichtungen erhöht sein.

Das EEPROM kann in einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung als FGFET (engl.: Floating gate field effect transistor) ausgebildet sein. Eine derartige FGFET-Struktur weist jeweils einen Source- und Drain-Anschluss auf, sowie zusätzlich einen Steueranschluss, das sogenannte Control gate. Im Bereich des Control-Gate befindet sich ein Bereich der als Floating-Gate bezeichnet wird. In diesem Bereich des Floating-Gates können Ladungen dauerhaft „abgespeichert“ werden. Je nach Ladungszustand des Floating-Gate-Bereichs ist die Source-Drain-Strecke hochohmig oder niederohmig. Dieser Unterschied kann beispielsweise zur Codierung der zu speichernden Information verwendet werden.

Ein entsprechender FGFET ist dann ebenfalls als 1-Poly-Struktur ausgebildet. Das Control-Gate ist folglich nicht als Doppelstruktur, bei der sich unterhalb des Control-Gates das Floating-Gate befindet, welches über ein Gateoxid vom übrigen Bulkmaterial abtrennt, sondern das Floating-Gate ist vielmehr als eine Schicht ausgebildet, die sich auch über den Bereich von Source nach Drain hin erstreckt. Der Bereich des Control-Gate kann vom Bereich der Source-Drain-Strecke dabei über einen weiteren Feldoxidbereich abgetrennt sein. Das Control-Gate kann in der Bulkstruktur außerhalb der Source-Drain-Strecke angeordnet sein.

Da das Floating-Gate in 1-Poly-Bauweise mit dem Control-Gate keine Stapelstruktur bildet, kann die Gatestruktur insbesondere auch ein Control-Gate in Form einer vergrabenen Schicht (Engl.: buried control gate) umfassen, welche im Bulkmaterial des Halbleiters selbst angeordnet ist (Ausführungen: z.B. ETOX, FLOTOX). Bei dieser vorgeschlagenen Bauweise kann zudem auch Material für die Oxidschicht eingespart werden, dass ansonsten bei einer 2-Poly-Struktur zur Isolation benötigt würde.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden in der analogen Schaltkreiskomponente subnominale Spalten ausgebildet, während in der digitalen Schaltkreiskomponente subnominale Linien gefertigt werden. Der Begriff "subnominal" bedeutet unterhalb der kritischen Dimension, d.h. unterhalb der kleinsten, direkt produzierbaren Strukturbreite. Als Herstellungsverfahren für diese Linien und Spalten dient das so genannte bi-subnominale-Ätzverfahren (Engl.: bi-subnominal etching), welches ermöglicht, besonders schmale Strukturen zu erzeugen, die mit herkömmlichen Etching-Verfahren und den dazugehörigen Masken nicht erreicht werden können. Durch dieses Verfahren können Strukturen erzeugt werden, die unter den minimalen kritischen Dimensionen liegen, die für einen Maskenschritt üblicherweise erreichbar sind. Durch diese schmalen Strukturen wird bei Halbleiterstrukturelementen wie EEPROMs oder CCDs ermöglicht, Ladungsträgerpakete über Felder

beeinflussen zu können, da die Abstände entsprechend gering ausgebildet sein können, ohne dass Strukturüberlappungen oder ähnliche Maßnahmen notwendig sind. Dieses Herstellungsverfahren eignet sich somit besonders dazu, möglichst kleine Strukturen herzustellen, wie sie beispielsweise bei CCDs vielfach erwünscht sind, um einen möglichst geringen Abstand zwischen den Gatestrukturen zu erreichen.

Die digitalen Schaltkreiskomponenten können entsprechend schmale Linien umfassen, z.B. also für kurze Transistoren, um eine dichte Packung an Transistoren zu ermöglichen und somit hohe Leistung bei der Signalverarbeitung erzielen zu können.

Ferner benötigen die analogen Schaltkreiskomponenten schmale Spalten zur Beeinflussung und zum Transport von freien Ladungsträgern über Felder sowie zur Detektion von Ladungspaketen (so genanntes free-charge handling).

Der Analog-/Digital-Wandler hingegen weist vorteilhafterweise wegen der Toleranz gegenüber hohen Spannungen breite Linien auf.

Hinsichtlich des Aufbaus der Halbleiterstruktur der Sensorvorrichtung ist im Übrigen grundsätzlich denkbar, dass analoge und digitale Schaltkreiskomponenten durch so genannte Guard-Ringe getrennt sind. Bei derartigen Guard-Ringen handelt es sich um hochdotierte Ringstrukturen, die abzugrenzende Halbleiter-Strukturbereiche umgeben, sodass damit die parasitären Widerstände sinken können und andererseits wiederum vagabundierende Ladungsträger von den Guard-Ringen abgefangen werden können. Darüber hinaus kann verhindert werden, dass abzuschirmende Halbleiterstrukturen infolge parasitärer Effekte angesteuert werden. Des Weiteren können auch einzelne Module von Guard-Ringen abgetrennt werden.

Es können eine Reihe von Modulen auf dem Chip gemäß der Erfindung integriert werden. Die digitale Schaltkreiskomponente kann bei einem Ausführungsbeispiel zudem

wenigstens einen der folgenden Module (neben der Digitaldomain zur Signalverarbeitung, dem AD-Wandler sowie dem nicht-flüchtigen Speicher) umfassen:

- eine Vorrichtung zur Kontrolle einer Phasenverschiebung, insbesondere eine DLL (engl.: Delay-locked loop),
- einen Zeitgeberschwingkreis, insbesondere eine PLL (engl.: Phase-locked-loop).

Zusätzlich kann die analoge Schaltkreiskomponente wenigstens eines der folgenden Module (neben dem Sensor und Modulen zum so genannten Free-charge Handling) umfassen:

- einen Sensor zur Detektion von Strahlung samt Struktur zum Transport von induzierten freien Ladungsträgern,
- ein Verstärker
- ein Spannungsregler
- ein Spannungswandler
- einen Temperatursensor.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung können auf einer Sensorvorrichtung gemäß der Erfindung als voll integriertes System-on-Chip folgende analogen und digitalen Module zusammen integriert sein: eine ToF-Pixelmatrix zur optischen Detektion, eine Spannungsversorgung bzw. Spannungsregulierung, der nicht-flüchtige Speicher für die entsprechende Konfiguration, ein LED-Treiber bzw. eine LED-Steuerung für die aktive Beleuchtung durch die Sensorvorrichtung, ein digitales SPI-Interface zur Kommunikation, der A-/D-Wandler, die PLL und weitere Daten verarbeitende oder zur flüchtigen Datenspeicherung verwendbare Elektronikkomponenten.

Die DLL kann beispielsweise die Phasenverschiebung zwischen LED und LED-Treiber selbständig messen und regeln. Der Zeitgeber wird durch einen entsprechenden Zeitgeberschwingkreis (PLL) stabilisiert.

Bei dem Sensor zur Strahlungsdetektion handelt es sich zum

Beispiel um eine Pixel-Matrix, die als CCD ausgebildet ist, und strahlungsinduzierte freie Ladungsträger über Felder beeinflusst und transportiert. Ein Temperatursensor wiederum kann dazu vorgesehen sein, eine Korrektur des Temperaturdrifts der gesamten Sensorvorrichtung vorzunehmen, wobei zum Beispiel entsprechende Kalibrierungsdaten, die als Konfigurationsparameter im EEPROM gespeichert sind, dazu verwendet zu werden. Dadurch, dass all diese Module in einem einzigen System-on-Chip vereint werden können, können zudem teure und platzraubende Peripheriekomponenten wie FPGAs (Engl.: field-programmable gate array) zur Abarbeitung logischer, A-/D-Wandler, Komponenten zur Stromversorgung usw. eingespart werden.

Die digitalen Schaltkreiskomponenten können grundsätzlich in CMOS-Prozessen (Engl.: complementary metal-oxide semiconductor) gefertigt werden.

Im vorliegenden Fall wird für eine Sensorvorrichtung gemäß der Erfindung ein besonderer CMOS-Prozess vorgeschlagen, der sich durch einige Vorteile, gerade im Bereich der Infrarotdetektion gegenüber Standard-CMOS-Verfahren auszeichnet. Handelsübliche Standard-CIS-Sensoren (Abkürzung für "CMOS Image Sensor") umfassen so genannte gepinnte Photodioden, deren photoempfindlicher Detektionsbereich nur eine Dicke von wenigen Mikrometern umfasst, also geringer ist als die Absorptionslänge von Licht einer Wellenlänge von 850 Nanometern in Silizium, nämlich einer Absorptionslänge von etwa 13 Mikrometer. Die hohe Quantenausbeute bei den nunmehr vorgeschlagenen CMOS-Komponenten wird ermöglicht zum einen durch eine Beleuchtung der Komponenten von der Rückseite (back-side illumination) sowie die äußerst kurzen Erfassungszeiten für die gebildeten Ladungsträger einer Detektion.

Die CCD-Sensoreinrichtung kann zum Beispiel wie folgt aufgebaut sein: Die Halbleiterstruktur zur Photonendetektion umfasst ein Substrat aus einem Halbleitermaterial mit einer ersten Dotierung, einen Kontaktbereich, der an der Vorderseite

des Substrates angebracht ist, eine Bias-Schicht aus einem Halbleitermaterial mit einer zweiten Dotierung, welche auf der Rückseite des Substrats beabstandet vom Kontaktbereich angeordnet ist, wobei der Kontaktbereich wenigstens teilweise der Bias-Schicht gegenüberliegt, so dass in lateraler Richtung ein Überlappbereich vorhanden ist, ein Guardring, der auf der Vorderseite des Substrats angeordnet ist und den Kontaktbereich umgibt, wobei zwischen dem Kontaktbereich und dem Guardring eine Sperrspannung anlegbar ist, dadurch aus, dass der Überlappbereich eine laterale Ausdehnung aufweist, die wenigstens ein Viertel der Distanz zwischen dem Kontaktbereich und der Bias-Schicht beträgt. Durch dieses Größenverhältnis kann nicht nur das Potential im Bulkmaterial durch das am Kontaktbereich angelegte Potential beeinflusst werden, sondern ebenfalls das Potential der Bias-Schicht. Es entsteht ein Potentialkanal, ein Leitungskanal zwischen dem Kontaktbereich und der gegenüberliegenden Bias-Schicht. Das Bulkmaterial kann für die Sensorvorrichtungen im Zonenziehverfahren gewonnen werden (Engl.: float-zone silicon). Dieses Material zeichnet sich durch sehr geringe Störstellen und durch besondere Homogenität aus. Die Leitfähigkeit liegt bei mehreren hundert Ohm x Zentimeter ( $\Omega$  cm) bis zu mehreren Kiloohm x Zentimeter ( $k\Omega$  cm). Die Sensorvorrichtung gemäß der Erfindung bzw. die entsprechende Ausführungsform kann durch diese Maßnahmen nicht nur eine besonderes gute Detektion ermöglichen; diese Maßnahmen lassen auch zu, dass die Sensorvorrichtung für verschiedenste Bedingungen geeignet ist, etwa unter Einfluss von Umgebungslicht und bei unterschiedlichsten optischen Eigenschaften der zu erfassenden Objekte, die sich zudem auch bewegen können.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktionen können bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung die Schaltkreiskomponenten bzw. die jeweiligen Module der Schaltkreiskomponenten für verschiedene Spannungen ausgelegt sein. Eine Funktion von Modulen der analogen Schaltkreiskomponente besteht in der Detektion und Beeinflussung von Ladungspaketen (engl. free-charge handling). Das entsprechende Detektionsmodul ist

beispielsweise Bestandteil des TOF-Sensors. Weitere Module der analogen Schaltungskomponente besitzen als Funktion unter anderem Spannungsregelung und Spannungswandlung, Temperaturerfassung, Verstärkung zur Unterdrückung von Untergrundrauschen, Module mit Treiberfunktion für die Leuchtdiode usw. Dementsprechend ist es vorteilhaft, dass die Module der analogen Schaltungskomponente für höhere Spannungen ausgelegt sind als die der digitalen Schaltungskomponente.

Die analogen und digitalen Schaltungskomponenten umfassen Halbleiterbauelemente, bei denen Oxidschichten zur elektrischen Isolierung eingesetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist etwa das Gateoxid, welches zum Beispiel bei einem Transistor das Gate vom übrigen Bulkmaterial trennt bzw. isoliert. Daneben können auch andere Oxidschichten vorhanden sein, beispielsweise das Feldoxid oder sonstige Zwischenoxidschichten. Um dementsprechend bei analogen Schaltungskomponenten ein Durchschlagen der Spannung vermeiden zu können, sind vorteilhafterweise bei einer Weiterbildung der Erfindung Oxidschichten der analogen Schaltungskomponenten dicker ausgebildet als die der digitalen Schaltungskomponenten. Die Dicken des Gateoxids des EEPROM können kleiner gewählt werden als die Dicken der Gateoxidschichten der Module der analogen Schaltungskomponente, aber wiederum größer als die Dicken der Gateoxidschichten in Modulen der digitalen Schaltungskomponente, z.B. der Digitaldomain. Vorzugsweise besitzen die Gateoxidschichten der analogen Schaltungskomponenten eine Dicke von 9 nm bis 15 nm, die Gateoxidschicht des EEPROM eine Dicke von 6 nm bis 10 nm und die Gateoxidschicht der übrigen digitalen Schaltungskomponenten eine Dicke von 1,5 nm bis 3 nm (wobei: nm: Abkürzung für Nanometer).

Darüber hinaus wird dementsprechend ein Verfahren zur Herstellung einer Sensorvorrichtung gemäß der Erfindung vorgeschlagen. Insbesondere kann wenigstens ein Teil des Verfahrens zur Herstellung ein 200-nm-CMOS-Fertigungsverfahren

umfassen. Es handelt sich dabei um ein Fertigungsverfahren, welches zum einen in der Halbleiterfertigung etabliert ist, jedoch hinsichtlich seiner Genauigkeit Anforderungen stellt, die immer noch eine vergleichsweise kostengünstige Produktion erlauben.

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung werden die Spalten und Linien der Halbleiterbauelemente mittels bi-subnominalem-Ätzverfahren hergestellt, welches ermöglicht, besonders schmale Strukturen zu erzeugen, die mit herkömmlichen Etching-Verfahren und den dazugehörigen Masken nicht erreicht werden können. Diese Maßnahme zur Herstellung ermöglicht insbesondere, die Sensorvorrichtung gemäß der Erfindung als voll integriertes System-on-Chip zur Verfügung stellen zu können.

Eine erfindungsgemäße Detektionsvorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Sensorvorrichtung gemäß der Erfindung vorgesehen ist. Die Detektionsvorrichtung kann beispielsweise als Überwachungseinrichtung dienen, welche die Bewegung eines Bewegungselementes, etwa eines Tors oder einer Tür, überwacht. Dabei sollen Kollisionen mit Objekten vermieden werden, etwa wenn Personen in einen Türspalt eingreifen und die Gefahr von Quetschungen besteht oder sonstige Gegenstände eingeklemmt werden, wobei auch der Antrieb der Tür dabei Schaden nehmen könnte.

Der Chip gemäß der Erfindung kann zum Beispiel auf eine Leiterplatte gelötet werden. Die Leiterplatte kann etwa mit der Spannungsversorgung ausgestattet sein. Falls eine aktive Beleuchtung notwendig ist, kann die Leiterplatte gegebenenfalls auch eine Lichtquelle, wie z.B. Leuchtdioden tragen. Denkbar ist grundsätzlich eine Verwendung der Sensorvorrichtung in verschiedensten Sensoreinrichtungen.

#### Ausführungsbeispiel:

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird nachstehend unter Angabe weiterer

Einzelheiten und Vorteile näher erläutert.

Im Einzelnen zeigen:

- Figur 1                    eine schematische Darstellung einer Sensorvorrichtung (SoC) gemäß der Erfindung;
- Figur 2                    eine schematische Darstellung der Zusammensetzung der Sensorvorrichtung mit PCB gemäß der Erfindung;
- Figur 3                    eine handelsübliche 2-Poly-Flash-Speicher-Zelle (EEPROM);
- Figur 4                    eine schematische Darstellung (gedanklich) des Übergangs von der 2-Poly-Flash-Zelle zur Einzel-Poly-Flash-Zelle;
- Figur 5                    eine schematische Darstellung eines 1-Poly-EEPROMs;
- Figuren 6 bis 17        den Ablauf eines bi-subnominal-Etching-Verfahren von Halbleiterbauelementen auf einem Substrat mit Strukturbreiten, die unter den kritischen Dimensionen liegen anhand schematischer Schnittbilder.
- Figuren 18 bis 29      eine Variante des Ätzverfahren gemäß Fig. 6 bis 17.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf eine Sensorvorrichtung 1 gemäß der Erfindung, die als voll integriertes System-on-Chip ausgebildet ist. Der gesamte Chip 1, wie er in Figur 1 dargestellt ist, besitzt eine Größe von 2,55 mm x 2,55 mm (wobei: mm: Abkürzung für Millimeter). Im einzelnen sind lediglich die Bereiche, in denen wesentliche Module angeordnet sind dargestellt; sonstige Elektronik, Leiterbahnen oder dergleichen, die ohnehin in der

Zeichnungsgröße im Einzelnen nur schwierig dargestellt werden können, sind in Figur 1 weggelassen. Der schematisch dargestellte Bestückungsplan zeigt unter anderem folgende Module und Schaltkreiskomponenten, nämlich die Digitaldomain 2 zur Signalverarbeitung, die Pixelmatrix 3 zur Detektion, den Spannungswandler (charge pump) 4, den Treiber für die Leuchtdiode (LED) 5, das EEPROM 6 zur Speicherung von Konfigurationsparametern, ein Modul 7, das sowohl einen Schwingkreis (PLL, Phase-locked loop) als auch eine Vorrichtung zum Messen und Regulieren der Phasenverschiebung zwischen LED und LED-Treiber (DLL, Delay-locked loop) umfasst.

Des Weiteren ist ein Modul dargestellt, welches Anteile von analoger und digitaler Schaltkreiskomponente aufweist, nämlich der A-/D-Wandler 8. Ferner sind Kontaktflächen 9 dargestellt. Der in Figur 1 dargestellte System-on-Chip 1, welcher in 1-Poly-Technologie gefertigt ist, ist die besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Für Überwachungszwecke kann die Pixelmatrix 8 x 8 Pixel umfassen. Jedes Pixel kann unabhängig von den anderen arbeiten. Ferner hat jedes Pixel wiederum zwei Ausgangskanäle, welche ausgelesen und analysiert werden können, um den relativen Phasenversatz zur Phase des ausgesendeten Lichts zu ermitteln. Bei Überwachungssensor ist es im Grunde ausreichend, eine einzelne Distanz zu vermessen, sodass es genügt, einen Mittelwert über die vorhandenen Pixel und deren ausgelesenen Informationen zu bilden. Die einzelnen Pixel können auch unterschiedlich gewichtet werden.

Für die dargestellte Ausführungsform des Chips 1 genügt eine einzelne Spannungsquelle, welche eine Spannung von 8,5 V zur Verfügung stellt, da weiter benötigte Spannungen über integrierte Spannungswandler bereitgestellt werden. Da der Sensor mit einer aktiven Beleuchtung arbeitet, dass heißt selbst über eine Lichtquelle verfügt, welche zur Detektion eingesetzt wird, sind im vorliegenden Fall als Leuchtmittel typischer Weise 1 bis 3 LEDs notwendig. Die Distanz kann beispielsweise über PWM (Pulz with modulation) oder über ein SPI-Register ausgelesen werden. Befehle und setzen der Register kann über SPI-Protokoll erfolgen.

Der Einsatz von CCD-Struktur ermöglicht insbesondere dass die Ladungsträgerpakete in kurzer Zeit beeinflusst bzw. detektiert werden können. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit dem Einsatz von TOF-Sensoren, da diese typischer Weise Detektionen im Bereich von einigen Nanosekunden leisten müssen. Im Wesentlichen wird die Antwort auf einen kurzen ausgesendeten Lichtpuls der LED dabei aufgezeichnet und vermessen. Der Sensorchip 1 ermöglicht zudem auch, Distanzmessungen in Bezug auf Gegenstände mit unterschiedlichem Reflexionsvermögen vorzunehmen. Die Entfernung kann dabei von einigen Zentimetern bis mehreren Metern typischerweise betragen.

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Sensorschaltung 10 mit einer Sensorvorrichtung als Chip 11, der auf einer Leiterplatte 12 (PCB, printed circuit board) aufgebracht ist. Zur Kontaktierung ist der Chip 11 direkt auf der Leiterplatte 12 aufgelötet. Auf der Leiterplatte 12 stehen zur Kontaktierung so genannte Pads 13 zur Verfügung. Diese Pads 13 oder Kontaktflecken stellen die Verbindung zu weiteren Leiterbahnen her. Der Chip 11 wird auf den Pads 13 über Lotkugeln (solder balls) 14 angebracht. Im Sensorbereich wird der Chip 11 von der Sensorrückseite her beleuchtet. Die einfallenden Photonen 15 treffen dabei zunächst auf eine Schicht aus Filtermaterial und Mikrolinsen 16. Darunter wiederum befindet sich das Bulkmaterial 17, welches im Wesentlichen aus in Zonenziehverfahren gewonnenem Silizium (Engl.: float-zone silicon) besteht. Die elektronischen Schaltkreise 18, welche unter anderem zur Detektion dienen, befinden sich auf der nicht beleuchteten Seite des Sensors (der eigentlichen "Vorderseite" des Halbleiterbauelements), welche der Leiterplatte 12 zugewandt ist. Der Bereich des Bulkmaterials 17 in welchen die einfallenden Photonen 15 gelangen liegt als völlige Verarmungszone vor. Die Photonen 15 wiederum erzeugen Ladungsträger 19 im Bulkmaterial 17, welche wiederum von den Schaltkreisen 18 des Sensors detektiert werden können.

Die Quantenausbeute eines Photodetektors hängt im Allgemeinen von folgenden vier Faktoren ab:

- Absorptionseigenschaften des Bulkmaterials (dass heißt von Silizium);
- der Dicke der nicht empfindlichen Schicht, in der kurze Rekombinationszeiten der erzeugten Ladungsträger vorherrschen (Diese Rekombinationszeiten sind besonders für den UV-Bereich mit kurzen Wellenlängen der limitierende Faktor);
- der Dicke der Verarmungszone, welche ein Abschneiden im langwelligen Bereich bedeutet;
- von den Reflektionseigenschaften der Oberfläche.

Insbesondere bei Anwendungen im Überwachungsbereich wird vielfach eine Detektion im Infrarotbereich verwendet. Eine Verbesserung im UV-Bereich kann beispielsweise dadurch erfolgen, indem die Nachbehandlung auf der Rückseite für ultradünne, unempfindliche Schichten optimiert wird. Im UV-Bereich beträgt die Absorptionslänge in Silizium nur wenige Nanometer. Ein solcher Optimierungsschritt hat grundsätzlich jedoch nichts mit dem verwendeten CMOS-Prozess zu tun. Gleiches gilt für die Oberflächeneigenschaften auf der Detektionsseite, der Rückseite der Halbleiterstruktur, d.h. insbesondere für das Reflexionsvermögen des Detektionsfensters. Der in Figur 2 dargestellte Sensor besitzt insbesondere den Vorteil, dass durch die Beleuchtung von der Rückseite grundsätzlich eine große Fläche zur Verfügung steht. Als Bulkmaterial bzw. als Grundbestandteil wird im Ziehverfahren gewonnenes Silizium verwendet. In der analogen Schaltkreiskomponente kann mit Spannungen in der Größenordnung bis 12 V gearbeitet werden.

Die vorgeschlagene Sensorvorrichtung ermöglicht eine Quantenausbeute in einem Wellenlängenbereich von 520 nm bis 900 nm von mehr als 80 %. Die zeitliche Genauigkeit liegt dabei sogar im Sub-Nanosekundenbereich. Die Sensorvorrichtung

kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Frames pro Sekunde betrieben werden.

Bei einer gegenwärtigen Ausführungsform besitzt der gesamte Sensor zusammen mit der Leiterplatte eine Größe von 17 mm x 28 mm, wobei in diesem Fall die Spannungsversorgung, die Steuerung und zwei LEDs zur aktiven Beleuchtung bereits mit inbegriffen sind. Der Sensor eignet sich damit insbesondere auch für Anwendungen im Überwachungsbereich, sodass kleine, unauffällige Überwachungssensoren eingesetzt werden können.

Darüber hinaus besitzt die Sensorvorrichtung einen vergleichsweise geringen Energieverbrauch. Ein besonders kritischer Faktor bezüglich des Energieverbrauchs ist die aktive Beleuchtung zur Entfernungsmessung mittels TOF-Sensor. Wird die Beleuchtung viel zu schwach gewählt, leidet mitunter die Genauigkeit der Entfernungsmessung. Bei der vorliegenden Ausführung reicht eine Energie von nur 30 fJ (Femtojoule) pro Pixel aus um ein Signal von ca. 100 000 Elektronen zu erzeugen und somit bei einer Wellenlänge von 850 nm des einfallenden Lichts einer Quantenausbeute von 80 % zu erreichen. Insgesamt brauchen die LEDs typischer Weise nur 50 % der benötigten Integrationszeit eingeschaltet zu sein.

TOF-Sensoren zeichnen sich gerade dadurch aus, dass ermöglicht wird, den durch Umgebungslicht (zum Beispiel Sonnenlicht) erzeugten Untergrund zu reduzieren. Dies ermöglicht zum einen eine besonders präzise Messung, aber auch wiederum, den Energieverbrauch zu erniedrigen, da die aktive Beleuchtung grundsätzlich schwächer gewählt werden kann.

Figuren 3 bis 5 zeigen einen nicht flüchtigen Speicher in Form eines EEPROMS 20. Der EEPROM 20 ist in Figur 3 zunächst in 2-Poly-Technologie gefertigt. Die Halbleiterstruktur besitzt die Anschlüsse Source S, Drain D sowie als Steueranschluss ein Control-Gate CG. Die Doppelstruktur aus Polysilizium umfasst im Bereich des Gates die Kontaktierung des Control-Gates CG und gestapelt darunter ein so genanntes Floating-Gate FG. Dieses Floating-Gate FG dient der Speicherung von Ladungen und

somit der Speicherung von Information. Im vorliegenden Fall befindet sich die Gate-Struktur auf einem Bulkmaterial 21 (hier: p-Substrat). Das Floating-Gate FG ist vom Bulkmaterial 21 über ein Gateoxid 22 abgetrennt. Im Randbereich ist die Speicherzelle durch ein so genanntes Feldoxid 23 isoliert. Ferner ist ein Tunneloxid vorgesehen. Die Ladung, die im Floating-Gate FG gespeichert werden soll, kann über Tunneleffekt beeinflusst werden. Die Anschlüsse im Bereich Source S und Drain D sind jeweils als hochdotierte (n+)-Schicht N+ ausgebildet (n: negative Dotierung, "+" bedeutet hohe Dotierung).

Figur 4 zeigt, wie gedanklich der Übergang von der 2-Poly-Struktur zur 1-Poly-Struktur erfolgt. Die Doppelstruktur wird gewissermaßen im Bereich des Floating-Gates FG "aufgetrennt" und „zur Seite geklappt“. Ansonsten entspricht die gedachte Struktur aus Figur 4 im Allgemeinen der Struktur aus Figur 3.

Figur 5 zeigt schließlich die 1-Poly-Struktur des EEPROMs 25. Diese Flash-Speicherzelle besitzt keine doppelte Schichtstruktur mehr. Außerhalb der Source-Drain-Strecke S - D ist, über ein Feldoxid 23 des Control-Gate als vergrabene hochdotierte (n+)-Schicht vorhanden (buried control gate). Das Control-Gate CG befindet sich unter einem Gateoxid, wobei darüber wiederum schließlich das Floating-Gate FG angeordnet ist. Über die Ansteuerung des Control-Gates CG erfolgt schließlich eine Beeinflussung des Floating-Gates FG, die ihrerseits dafür sorgt, dass die Source-Drain-Strecke S-D ihren Widerstand ändert. Die zu speichernde Information kann entsprechend codiert werden.

#### Bi-subnominal etching:

Es handelt sich dabei um ein Verfahren zur Herstellung von Halbleiterbauelementen auf einem Substrat mit fotolithographischen Strukturierungsschritten, bei welchem auf dem Substrat eine erste zur strukturierende Schicht und eine für die erste zu strukturierende Schicht als Maskenschicht dienende zweite Schicht aufgebracht wird. Zudem wird eine als

Maske für die zweite Schicht dienende dritte Schicht aufgebracht und nacheinander zumindest zwei fotolithographische Strukturierungsprozesse für die zweite Schicht durchgeführt, wobei bei einem der Strukturierungsprozesse nach der Erzeugung einer Struktur aus einer fotoempfindlichen Schicht zur Bereitstellung einer Maskenschicht für einen Strukturierungsprozess an der dritten Schicht, an den Strukturierungsändern der dritten Schicht positive Rampenwinkel erzeugt werden, wodurch sich die freibleibenden Strukturen bei einer Dicke  $h$  der dritten Schicht um einen Wert  $D=2 \cdot h / \tan \alpha$  verkleinern und wobei beim Anderem der Strukturierungsprozesse nach der Erzeugung einer Struktur aus einer fotoempfindlichen Schicht für die Bereitstellung einer Maskenschicht für einen Strukturierungsprozess an der dritten Schicht, an den Strukturierungsändern der dritten Schicht negative Rampenwinkel  $\beta$  erzeugt werden, wobei sich die verbleibenden Strukturen bei einer Dicke  $h$  der dritten Schicht um einen Wert  $W=2 \cdot h / \tan \beta$  verkleinern und wobei auf der Basis der jeweils strukturierten dritten Schicht eine Strukturierung der zweiten Schicht erfolgt.

Ausgangspunkt ist z. B. ein Wafer 100 aus Silizium mit dotierten Bereichen 101, geätzten Strukturen 102, die z. B. als aktive Bereiche eines Transistors genutzt werden, bei welchem die Lücken zwischen den geätzten Strukturen mit Isolationsmaterial aufgefüllt sind, in Prozessen wie z. B. STI (shallow trench isolation) oder LOCOS (Local oxidation of silicon). Auf den Wafer 100 kann ein Dielektrikum 103 aufgebracht sein, das als Dielektrikum für Transistorstrukturen dient. Schließlich folgt auf diese Isolationsschicht eine Schicht aus z. B. Polysilizium, das später zur Herstellung des Gates der Transistoren genutzt wird, beispielsweise in einer Dicke von 200 nm. Die Polysiliziumschicht trägt das Bezugszeichen 200 (siehe Figur 6).

Auf die Schicht 200 wird im Weiteren eine Isolationsschicht, insbesondere eine Siliziumoxidschicht 300 aufgetragen. Diese

Schicht sollte chemische Eigenschaften aufweisen, die unterschiedlich zu dem von der darunterliegenden Schicht 200 sind und weist z. B. eine Dicke von 50 nm auf. Damit kann diese Schicht nach ihrer Strukturierung als Maske für die Strukturierung der darunterliegenden Schicht eingesetzt werden.

Darauf wird ein Schichtstapel 400 aufgetragen, der aus verschiedenen Schichten bestehen kann, z. B. eine Antirefleksionsbeschichtung 401 sowie eine Photolackschicht 402 aufweist (siehe Figur 7).

Die Photolackschicht wird strukturiert, um eine erste Maske für die darunterliegende Schicht 401 zu erhalten. Dabei werden nur die Strukturen in der Photolackschicht realisiert, mit welchen kleinere Spaltbreiten als die kritische Dimension kreiert werden sollen. Selbstverständlich kann dieser Maskenschritt auch genutzt werden, um Strukturen zu erzeugen, die größer als die minimale Struktur sind. Darüber hinaus können in diesem Maskenschritt Strukturen entstehen, die eine Größe der minimalen Linien im Hinblick auf deren kritische Dimension besitzen. Grundsätzlich wird beim fotolithographischen Prozess das Kriterium der minimalen Strukturbreite eingehalten. Die kleineren Strukturbreiten als die minimale Strukturbreite ergeben sich durch einen nachfolgenden Strukturierungsschritt auf der Grundlage eines fotolithographischen Prozesses im Bereich der minimal möglichen Strukturbreiten.

Letztlich verbleibt eine strukturierte Photolackschicht 402 mit Öffnungen 403 (siehe Figur 8). Mit dieser strukturierten Photolackschicht wird nunmehr die Schicht 401 strukturiert. Ein bevorzugter Ätzschritt findet vorteilhafterweise so statt, dass in der Schicht 401 an den Rändern der Strukturen ein positiver Rampenwinkel entsteht. Damit werden in der Schicht 401 Öffnungen 420 erzeugt, die im Wesentlichen einem konstanten Offset von  $D=2 \cdot h / \tan \alpha$  besitzen, wobei  $h$  die Dicke der Schicht 401 ist. Der Winkel  $\alpha$  ist per Definition der Winkel, welcher von der schrägen Berandung der Schicht 401 und

der Ebene des Wafers eingeschlossen wird. Das bedeutet, dass ein Winkel  $\alpha$  von  $> 90^\circ$  einem positiven Rampenwinkel entspricht, bei dem Öffnungen 420 mit reduzierter Größe entstehen, wogegen bei einem Winkel  $\alpha < 90^\circ$  ein negativer Rampenwinkel vorliegt, bei welchem Öffnungen in der Dimension sich vergrößern. In Figur 9 werden jedenfalls im vorliegenden Schritt Öffnungen 420 verkleinert. Der Rampenwinkel ist positiv (siehe Figur 9).

Mit der strukturierten Schicht 401 wird die darunterliegende Schicht 300 (Maskenschicht) strukturiert. Dadurch erhält man Strukturen 320 (Öffnungen) in der Schicht 300, die den Öffnungen 420 in der Schicht 401 an deren Schichtgrund entsprechen (siehe Figur 10 sowie Figur 11). In Figur 11 ist die Schicht 402 bzw. 401 vor dem nächsten Prozessschritt vollständig entfernt.

Gemäß Figur 12 wird eine Schicht 411 bzw. 412 aufgetragen, wobei die Schicht 411 der Schicht 401 und die Schicht 412 der Schicht 402 entspricht. Die Schicht 412 ist eine Photolackschicht, die entsprechend der Strukturen strukturiert wird, bei welchen eine kleinere Linienbreite erreicht werden soll, als eine Linienbreite, die nach der kritischen Dimension noch möglich ist (siehe Figur 13). In Figur 13 sind Linien 430 ersichtlich. Diese Linien 430 sind unter Nutzung der fotolithographischen Möglichkeiten größer oder gleich der minimalen Linienbreite.

Mit der strukturierten Schicht 412 mit Linien 430 wird die darunterliegende Schicht 411 strukturiert in einer Weise, dass negative Rampenwinkel entstehen. Dadurch verkleinern sich die verbleibenden Linien 430 um jeweils den Rampenwinkelbereich, d. h. die Linien werden um den Wert  $W=2 \cdot h / \tan \beta$  kleiner, wobei  $\beta$  der Winkel zwischen der Substrat-Oberfläche und dem nach innen geneigten Rand ist (siehe Figur 14 und Figur 15).

Mit den strukturierten Linien 430 in der Schicht 411 wird die darunterliegende Schicht 300 erneut strukturiert, wobei die Breite der Linien am unteren Rand am Übergang zur Schicht 300

auf die darunterliegende Schicht 300 übertragen wird. Es entstehen subnominale Linienstrukturen, die kleiner sind als die fotolithographische Linienbreite.

Daraufhin werden die Schichten 412 und 411 vollständig entfernt und mit der strukturierten Schicht 300 ein erneuter Strukturierungsvorgang durchgeführt.

Die Schicht 300 enthält nun subnominale Spaltbreiten und subnominale Linienbreiten im Vergleich zu einer kritischen Dimension an den vorgegebenen Stellen. Natürlich kann die Schicht 300 größere Strukturen sowie Strukturen enthalten, die der kritischen Dimension entsprechen.

Mit der strukturierten Schicht 300 wird die darunterliegende Schicht 200, mit welchen die Gates der Transistoren hergestellt werden, strukturiert.

Anschließend ist es möglich, die Schicht 300 zu entfernen und es verbleibt eine strukturierte Polysiliziumschicht 200 mit subnominalen Spalten 220 und subnominalen Linien 230 (vgl. Fig. 17).

Anschließend kann ein herkömmlicher CMOS-Prozess durchgeführt werden.

Um die minimalen Strukturen zu nutzen, sollte im Folgenden eine Implantation zur Erzeugung von Source/Drain-Bereichen in den Bereichen subnominaler Spaltbreiten vermieden werden.

In der Variante des Ätzverfahrens gemäß den Figuren 18 bis 29 kommen die gleichen Schichten zur Anwendung, wie im Verfahren gemäß den Figuren 6 bis 17, weshalb für die Schichten und die Strukturen die gleichen Bezugszeichen verwendet werden.

Unterschiedlich zum Herstellungsverfahren nach den Figuren 6 bis 17 ist im Herstellungsverfahren nach den Figuren 18 bis 29 die Prozessfolge und die Schichtfolge. Das Herstellungsverfahren, veranschaulicht von Figur 18 bis Figur 21, entspricht dem der Figuren 6 bis 9. Im Unterschied zum

Verfahren gemäß der Figuren 6 bis 17 wird jedoch nicht mittels der strukturierten Schicht 401 die darunter liegende Maskenschicht 300 nach Erzeugung der Öffnungen 420 strukturiert, sondern die Fotolackschicht 402 vollständig entfernt (siehe Figur 22) und eine erneute Fotolackschicht (412) aufgetragen. Wie beim Verfahren gemäß der Figuren 1 bis 12 wird die Schicht 412 entsprechend der Strukturen strukturiert, bei welchen eine kleinere Linienbreite erreicht werden soll, als eine Linienbreite, die nach der kritischen Dimension fotolithographisch noch möglich ist. In Figur 24 sind Linien 430 ersichtlich. Diese Linien 430 sind unter Nutzung der fotolithographischen Möglichkeiten größer oder gleich der minimalen Linienbreite.

Mit der strukturierten Schicht 412 mit Linien 430 wird die darunter liegende Schicht 400 strukturiert in einer Weise, dass negative Rampenwinkel entstehen. Dadurch verkleinern sich die verbleibenden Linien 430 um jeweils den Rampenwinkelbereich (siehe Figur 25). Anschließend wird die Fotolackschicht 412 entfernt (siehe Figur 26), wobei eine strukturierte Schicht 401 verbleibt, mit welcher die darunter liegende Schicht 300 (Maskenschicht) strukturiert wird. Entsprechend der Breite der Öffnungen bzw. Linien am Schichtgrund werden diese Dimensionen im Strukturierungsprozess auf die Schicht 300 übertragen und zwar in einem einzigen Strukturierungsschritt, wogegen im Verfahren gemäß der Figuren 6 bis 17 zwei Strukturierungsschritte für die Schicht 300 zur Anwendung kommen.

Die strukturierte Schicht 300 ist in Figur 22 ersichtlich. Der weitere Prozessablauf gemäß der Figuren 23 und 24 entspricht dann wieder dem Prozessablauf gemäß der Figuren 16 und 17.

## Bezugszeichenliste:

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 1   | System-on-Chip                |
| 2   | Digitaldomain                 |
| 3   | Pixelmatrix                   |
| 4   | Spannungswandler              |
| 5   | LED-Treiber                   |
| 6   | EEPROM                        |
| 7   | PLL-/DLL-Modul                |
| 8   | A/D-Wandler                   |
| 9   | Kontaktfläche                 |
| 10  | Sensorschaltung               |
| 11  | Chip                          |
| 12  | Leiterplatte                  |
| 13  | Pad                           |
| 14  | Lotkugel                      |
| 15  | Licht                         |
| 16  | Filterschicht mit Mikrolinsen |
| 17  | Bulkmaterial                  |
| 18  | Elektronikschaltkreise        |
| 19  | Ladungsträger                 |
| 20  | 2-Poly-EEPROM                 |
| 21  | p-Substrat                    |
| 22  | Gateoxid                      |
| 23  | Feldoxid                      |
| 24  | Tunneloxid                    |
| 25  | 1-Poly-EEPROM                 |
| 100 | Wafer                         |
| 101 | dotierte Bereiche             |
| 102 | Strukturen                    |
| 103 | Dielektrikum                  |
| 200 | Polysilizium                  |
| 220 | subnominale Spalte            |
| 230 | subnominale Linie             |
| 300 | Maskenschicht                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 320 | Strukturen       |
| 400 | Schichtstapel    |
| 401 | BARC-Schicht     |
| 402 | Photolack        |
| 403 | Öffnung          |
| 411 | BARC-Schicht     |
| 412 | Photolack        |
| 420 | Öffnung          |
| 430 | Linie            |
| CG  | Control-Gate     |
| D   | Drain-Anschluss  |
| FG  | Floating-Gate    |
| N+  | (n+) -Schicht    |
| S   | Source-Anschluss |

Ansprüche:

1. Sensorvorrichtung (1, 11), insbesondere Time-of-flight- (TOF-) und/oder CCD-Sensorvorrichtung für einen 3-D-Kamerasensor, die wenigstens eine analoge und eine digitale Schaltkreiskomponente sowie einen Analog-/Digital-Wandler (8) zum Wandeln analoger Signale der analogen Schaltkreiskomponente in digitale Signale für die digitale Schaltkreiskomponente (2) und umgekehrt aufweist, wobei die analoge Schaltkreiskomponente sowie die digitale Schaltkreiskomponente jeweils wenigstens ein Modul zur elektronischen Ausführung einer Funktion umfassen, und wobei eines der Module der analogen Schaltkreiskomponente als Sensoreinrichtung (3) zur Detektion elektromagnetischer Strahlung und eines der Module der digitalen Schaltkreiskomponente als Signalverarbeitungseinrichtung zur Verarbeitung digitaler Signale ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltkreiskomponenten einschließlich dem Analog-/Digital-Wandler als integrierter Schaltkreis in einem Chip integriert sind und der Chip als Halbleiterstruktur in 1-Poly-Technologie gefertigt ist.

2. Sensorvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Module der digitalen Schaltkreiskomponente als nicht-flüchtiger Speicher, insbesondere als EEPROM (6, 25) (engl.: Electrically erasable programmable read-only memory), zum Speichern von Konfigurationsparametern ausgebildet ist.

3. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die digitale Schaltkreiskomponente in CMOS-Technologie gefertigt ist.

4. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das EEPROM (6, 25) als FGFET

(engl.: Floating gate field effect transistor) ausgebildet ist.

5. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der FGFET eine Control-Gate-Struktur mit einer vergrabenen Schicht (buried control gate) umfasst.

6. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der analogen Schaltkreiskomponente subnominale Spalten und/oder in der digitalen Schaltkreiskomponente subnominale Linien ausgebildet sind.

7. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die digitale Schaltkreiskomponente wenigstens eines der folgenden Module umfasst:

- eine Vorrichtung (7) zur Kontrolle einer Phasenverschiebung, insbesondere eine DLL (engl.: Delay-locked loop),
- einen Zeitgeberschwingkreis (7), insbesondere eine PLL (engl.: Phase-locked loop).

8. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die analoge Schaltkreiskomponente wenigstens eines der folgenden Module umfasst:

- einen Sensor zur Detektion von Strahlung samt Struktur zum Transport von induzierten freien Ladungsträgern,
- einen Verstärker,
- einen Spannungsregler,
- einen Spannungswandler (4),
- einen Temperatursensor zur Erfassung und Korrektur temperaturbedingter Drift.

9. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die analogen Schaltkreiskomponenten für höhere Spannungen ausgelegt sind als die digitalen Schaltkreiskomponenten.

10. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die analogen und digitalen Schaltkreiskomponenten Halbleiterbauelemente mit Oxidschichten zur elektrischen Isolierung, insbesondere mit einer Gateoxidschicht, umfassen, wobei wenigstens eine der Oxidschichten der analogen Schaltkreiskomponenten dicker ausgebildet ist als die der digitalen Schaltkreiskomponenten.

11. Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gateoxidschicht der analogen Schaltkreiskomponente eine Dicke von 9 Nanometer bis 15 Nanometer, die Gateoxidschicht des EEPROM eine Dicke von 6 Nanometer bis 10 Nanometer und die Gateoxidschicht der übrigen digitalen Schaltkreiskomponente eine Dicke von 1,5 Nanometer bis 3 Nanometer aufweisen.

12. Verfahren zur Herstellung einer Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche.

13. Verfahren nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil des Verfahrens ein 200-nm-CMOS-Fertigungsverfahren umfasst.

14. Verfahren nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass subnominale Spalten und/oder subnominale Linien mittels bi-subnominalem Ätzverfahren hergestellt werden.

15. Detektionsvorrichtung (10), insbesondere Überwachungsvorrichtung zur Überwachung der Bewegung eines

Bewegungselementes gegen ungewollte Kollisionen mit einem Objekt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sensorvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche zur Erfassung des Objekts vorgesehen ist.